

第15回電子回路世界大会(ECWC)で太陽ホールディングスが 最高賞、太陽インキ製造がメリットアワードを受賞

第15回電子回路世界大会(ECWC)(2020年11月30日から12月2日に開催)において、太陽ホールディングス株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:佐藤 英志、証券コード:4626)は最高賞を受賞しました。また、子会社である太陽インキ製造株式会社(本社:埼玉県比企郡嵐山町、代表取締役社長:峰岸 昌司)はメリットアワードを受賞しました。アワードは独創性、革新性、議論の質の観点から優れた論文に授与されました。

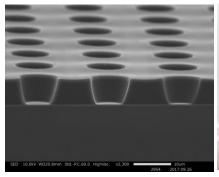
【ゴールドアワード(最高賞)】

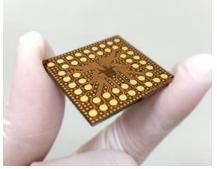
発表テーマ: 「Development of novel low-temperature curable positive-tone photosensitive

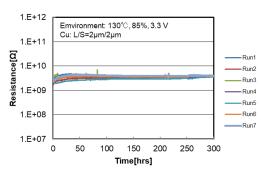
polybenzoxazole with high reliability]

<u>受 賞 者</u>: 太陽ホールディングス株式会社 研究本部 福島 智美、秋元 真歩、Lim Yeonjeong

発表論文概要: ファンアウトウェーハ/パネルレベルパッケージの銅再分配層(RDL)の誘電体層として開発された低温硬化性のポジ型感光性ポリベンゾオキサゾール(PSPBO)の課題であった、低耐熱衝撃性、低接着性を克服した、新規低温硬化性ポジ型感光性ポリベンゾオキサゾールについて論じたものです。







本開発品による微細パターン形成例 基板:銅スパッタシリコンウエハビア径(bottom)φ6μm

絶縁信頼性評価用チップ

絶縁信頼性の評価結果 銅配線 L/S=2/2(μm) 300時間以上の良好な絶縁性を示している

【メリットアワード】

<u>発表テーマ</u>: 「Development of organic inorganic composite materials for 5G application」

受 賞 者 : 太陽インキ製造株式会社 先行技術プロジェクト 竹村 美里、高 明天、志村 優之

発表論文概要: 5G以降の高速通信向けの電子部品の材料要求される、高周波帯において高透磁率かつ低損失という磁気特性を持つ新規磁性材料について論じたものです。今回発表した新規磁性材料は、太陽インキ製造の熱硬化樹脂の技術を最適な磁性体と組み合わせる事で、5G向けに要求される磁気特性を持ちながら良好な作業性と信頼性を併せ持ちます。

電子回路世界大会について

電子回路世界大会(ECWC)は、世界各地で3年ごとに開催される、国際PCB(プリント基板)シンポジウムです。ECWCは、国内のPCB産業と経済活動を、各国・地域の全ての地域で促進することを目的としています。同業者の学習を奨励し、世界のPCB需要、PCB製造プロセス、および5G、自動運転、スマートワールドなどのトレンドの変化する市場ダイナミクスにより良く対処するための技術を提供する貴重なプラットフォームを提供しています。

大会ウェブサイトURL: http://www.ecwc15.org/en/newsNreportsDetail.php?id=11